

住友ベークライトケミカルソリューション株式会社 発足のお知らせ

住友ベークライト株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:鍛冶屋 伸一)は、京セラ株式会社(以下「京セラ」)のケミカル事業の一部を承継する新会社の全株式を取得し、2026 年 10 月 30 日付で、同社が「住友ベークライトケミカルソリューション株式会社」として発足したことをお知らせいたします。

本件は、京セラが営むケミカル事業のうち、半導体封止用エポキシ樹脂成形材料、半導体用ボンディングペーストおよび工業用樹脂等に関する事業を、京セラが新たに設立した会社が吸収分割により承継したうえで、当社が同社の全株式を取得するものです。

本件の目的

当社は中期経営計画 2024-26 のもと、事業ポートフォリオの変革と事業拡大を戦略的に推進しています。今回、京セラのケミカル事業の一部を承継する新会社を当社グループに迎えることで、ICT 領域における存在感を一層高めるとともに、高付加価値製品を創出する技術力の強化を加速します。

当社が半導体封止用エポキシ樹脂成形材料や半導体用ボンディングペーストなどの分野で培ってきた技術力と、新会社が有する独自技術を融合し、成長が見込まれる AI データセンター用途等において、より幅広い顧客ニーズに応えていきます。

当社は、本件を通じて「2030 年ありたい姿」の実現をより確かなものとし、「未来に夢を提供する会社」として社会に貢献します。

新会社の概要

名称	住友ベークライトケミカルソリューション株式会社
所在地	東京都品川区東品川二丁目 5 番 8 号
代表者	代表取締役社長 森 健
事業内容	半導体封止用エポキシ樹脂成形材料、半導体用ボンディングペースト、工業用樹脂等の製造および販売
資本金	2 億円
株主	住友ベークライト株式会社 100%

新会社ロゴ

 住友ベークライトケミカルソリューション株式会社

【本件に関するお問い合わせ先】

住友ベークライトケミカルソリューション株式会社

製品に関するお問い合わせ KC_chemicalproducts_inquiry@ml.sumibe.co.jp